

# Quadratischer Ptfе Wafer-Reinigungsbehälter Fluoropolymer Halbleiter-Ätzkorb Individueller Silizium-Wafer-Träger

Artikelnummer: PL-CP89



## Einführung

Optimieren Sie Halbleiter-Nassbankprozesse mit unseren maßgefertigten quadratischen PTFE-Wafer-Reinigungsbehältern. Diese Fluoropolymer-Träger, entwickelt für extreme chemische Beständigkeit und hochreine Handhabung, bieten überlegene Haltbarkeit und Präzision für kritisches Siliziumwafer-Ätzen und Reinigen.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Siliziumwafer-Ätzen	Substrattauchen in sauren Ätzmitteln zum Entfernen von Oberflächenschichten oder Erzeugen spezifischer Texturen.	Außergewöhnliche Beständigkeit gegen HF- und Salpetersäuregemische.
Solarzellenreinigung	Mehrstufige Reinigung von großformatigen quadratischen Photovoltaik-Wafern vor Dotierung oder Beschichtung.	Hohe Handhabungskapazität mit minimalem Bruch.
MEMS-Verarbeitung	Handhabung von mikroelektromechanischen Systemen während kritischer chemischer Freisetzungsschritte.	Hochreine Umgebung verhindert mikroskopische Kontamination.
Ultraschallreinigung	Einsatz in Ultraschallbädern zum Entfernen submikroner Partikel von Präzisionsoptiken oder Elektronik.	Dämpfungseigenschaften schützen empfindliche Teile vor Vibrationsschäden.
Spuremetallanalyse	Vorbereitung und Reinigung von Laborgeräten in hochreinen Säurebädern für die analytische Chemie.	Geringstmögliche Hintergrundinterferenz für PPB-Nachweis.
LED-Substrathandhabung	Unterstützung für Saphir- oder Siliziumkarbid-Wafer durch aggressive Reinigungs- und Spülzyklen.	Langfristige Zuverlässigkeit in Hochtemperatur-Chemieprozessen.
Chemikalienlagerung & Transport	Sichere Aufbewahrung empfindlicher Substrate während des Transports zwischen Reinraummodulen.	Nicht-reaktive Oberflächen schützen die Waferoberflächenchemie.
Laborforschung	Maßgefertigter Träger für experimentelle Materialverarbeitung in Universitäts- und F&E-Laboren.	Anpassbares Design für nicht-standardisierte experimentelle Aufbauten.

Spezifikationskategorie	Parameterdetails für PL-CP89
Modellbezeichnung	PL-CP89
Standardabmessungen	249mm x 249mm (Quadratische Konfiguration)
Materialzusammensetzung	100% Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen)
Chemische Kompatibilität	Universal (Außer geschmolzene Alkalimetalle und elementarer Fluor)
Temperaturbereich	-200°C bis +260°C (-328°F bis +500°F)
Fertigungsmethode	Vollständige CNC-Bearbeitung aus massivem Block
Wafer-Kapazität	Vollständig anpassbar (Variable Schlitzanzahl und -abstand)
Schlitzbreite	Präzisionsgefräst (Anpassbar an Waferdicke)
Entwässerungsmerkmale	Integrierte Basis- und Seiten-Durchflussöffnungen für Flüssigkeitsaustausch

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Spezifikationskategorie	Parameterdetails für PL-CP89	
<b>Griffoptionen</b>	Optionale abnehmbare oder integrierte PTFE-Griffe verfügbar	
<b>Oberflächenbeschaffenheit</b>	Glatte, nicht poröse gefräste Oberfläche zur Verhinderung von Partikeleinschlüssen	
<b>Konformität</b>	RoHS-konform, FDA-zugelassene Rohmaterialien	